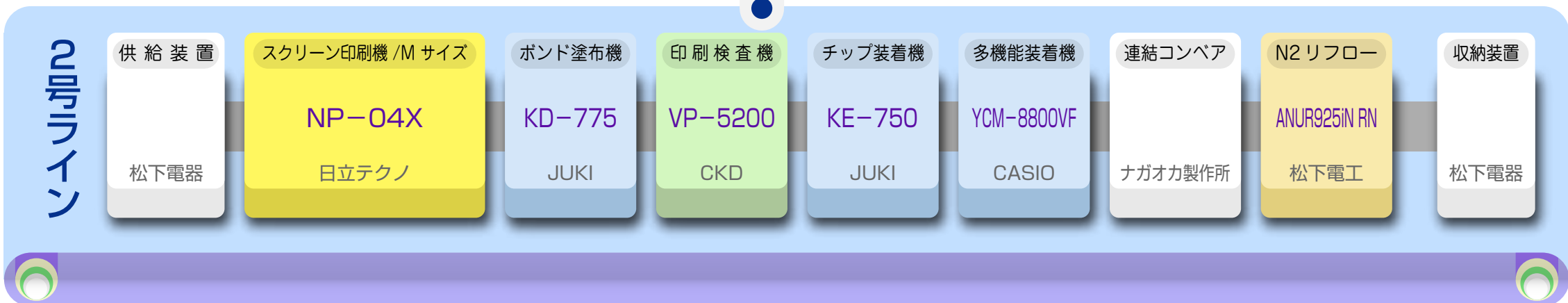


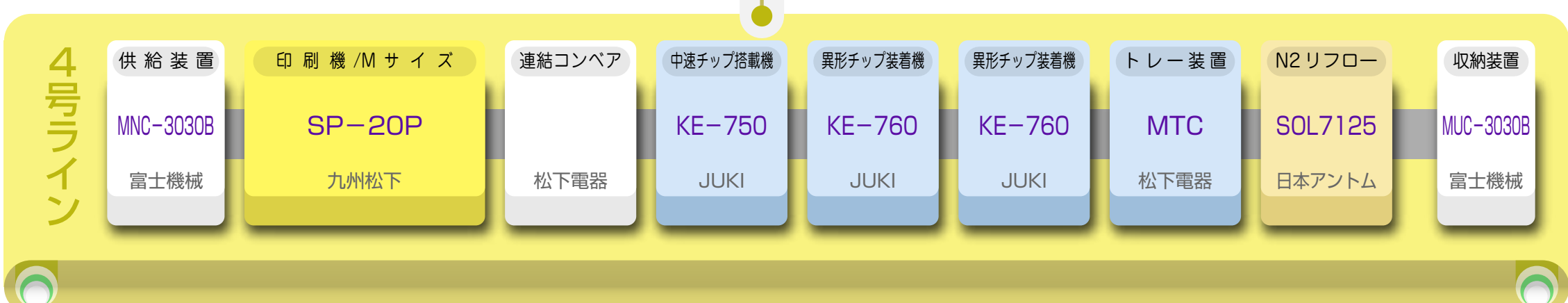
- ### 1号ラインの特徴
1. 大形サイズの基板の表面実装が可能 (Min 50×50 Max 508×381)
 2. 自装タクト 最大 0.1s (チップ部品装着時)
 3. QFP リードピッチ 0.3mm まで実装可能
 4. BGA/CSP ポールピッチ 0.3mm まで実装可能

- ### 2号ラインの特徴
1. 小ロット M サイズ基板 (Min 50×50 Max 330×250) 自装可能
 2. 自装タクト 最大 0.09s (チップ部品装着時)
 3. QFP リードピッチ 0.3mm まで実装可能
 4. BGA/CSP ポールピッチ 1.0mm まで実装可能



- ### 3号ラインの特徴
1. 少量実装点数もしくは小中量ロット基板の実装を効率的に実施 (対応基板サイズ Min 50×50 Max 330×250)
 2. 自装タクト 最大 0.3s (チップ部品搭載時)
 3. QFP リードピッチ 0.3mm まで実装可能
 4. BGA/CSP ポールピッチ 1.0mm まで実装可能

- ### 4号ラインの特徴
1. 少量実装点数もしくは小中量ロット基板の実装を効率的に実施 (対応基板サイズ Min 50×50 Max 330×250)
 2. 自装タクト 最大 0.3s (チップ部品搭載時)
 3. QFP リードピッチ 0.3mm まで実装可能
 4. BGA/CSP ポールピッチ 1.0mm まで実装可能



自動目視検査設備

基本はんだ検査装置 オムロン VT-WIN-II

装着部品確認装置 日本マランツ M22X-DL460 (Lサイズ) M22X-350DL
日本マランツ M22X (Mサイズ) M22X-FW450
M22X-450